

コードNO

2023年度事業計画

実装技術標準化専門委員会

委員会の役員	委員長：二宮良次（東芝） 副委員長：中林種広（村田製作所）、池田靖（日立製作所） 幹事：諏訪正樹（KOA）、山田 浩（東芝）、（客員）小島智（コジマイーデザインオフィス）、（客員）春日壽夫（国際Jissoセンター）、（客員）坂本一三（エス・シー・エル）、川又哲治（日立製作所）、 監事：松岡 誠二（ソニーGMO）
委員会の構成	17社44名（内 客員6名、オブザーバ2名）
委員会の会費	144千円×17社=2,448千円
会議開催の予定	第105回 4月26日（水）：JEITA Web Meeting 第106回 6月28日（水）：JEITA Web Meeting 第107回 9月29日（金）：JEITA Web Meeting 第108回 12月13日（水）：JEITA Web Meeting 第109回 2月21日（水）：JEITA Web Meeting 他に、実装技術標準化専門委員会の開催日前に幹事会を計5回開催
委員会の下部組織	(1) はんだ付け試験標準化G (2) 実装CADライブラリ&データフォーマット標準化グループG (3) 接合耐久性試験方法G (4) 電子実装用語G (5) ウィスカ及び実装材料研究会 (6) サーマルマネジメント標準化G (7) スルーホールリフロー実装に係わる要求事項標準化PG (8) 部品内蔵型三次元実装技術標準化G (9) 実装用MIDテクニカルレポートPG (10) 電力デバイス接合材料の国際標準化フォローアップPG
事業計画の概要	<p>〈活動の目的〉</p> <p>電子実装技術に関して、日本の実装技術を中心とした関連業界（機器セット・半導体・電子部品・材料など）に共通の課題、競争力強化に必要な事項の国際標準化を行う。規格・ガイドラインに関する審議検討・試験検証は、専門委員会直下に標準化G（Group）を組織すると共に、必要に応じて、標準化Gまたは専門委員会直下に個別テーマ対応のPG（Project Group：専門家検討チーム）を新たに設置して推進する。</p> <p>本専門委員会は、IEC TC91 国内委員会の審議機関としての役割を果たすため、実装技術分野での戦略的な国際標準化を、国際調整組織（JIC, LCG等）、関連する半導体領域・部品領域・プリント配線板領域・はんだ材料領域の標準化組織などと連携しながら、以下の事業推進を行う。</p> <p>(1) JEITA 規格の制定・改定 (2) JIS 規格草案の作成 (3) IEC TC91 規格案の作成・提案・検討・審議・投票、国際間調整 (4) 規格化・標準化のための調査・研究・検証 (5) 活動成果の広報・普及（報告会、講演会、出版、WEB発信） (6) 関連団体との連携（JEITA 内委員会、JPCA, JWES など） (7) 海外業界団体（JIC）との合同会議 JIC: Jisso International Council（日米欧の実装技術関連団体の交流会活動）</p> <p>〈新規事項〉</p> <p>(1) JEITA 規格の制定・改定 ・JIS-C5603（プリント回路用語）の改正 (2) JIS 草案作成・JIS 原案作成委員会の参加 ・なし</p>

- (3) IEC 国際規格案の作成・提案・検討・審議・投票, 国際間調整
 - ・ IEC 61760-3-1 Surface mounting technology のテクニカルレポート作成
 - (4) 標準化 G, PG 設立・改廃
 - ・ JEITA 実装技術標準化専門委員会の下部組織体制の構築再検討 (委員数に見合った統廃合の検討)
 - ・ 電力デバイス接合材料の国際標準化フォローアップ PG の設立
 - (5) 規格化・標準化のための調査・研究・検証
 - ・ はんだ (新規材料系) でのはんだ付け試験の調査検討
 - ・ ウィスカの長期信頼性の規格構築の予備調査
 - (6) 活動成果の広報・普及 (報告会, 講演会, 出版, WEB 発信)
 - ・ JEITA 電子実装標準化活動報告会 2021
 - (7) 国際標準化会議参加
 - ・ IEC TC91/WG3 ヘルシンキ会議 (2023 年 6 月)
 - ・ IEC TC91/WG3 済州会議 (2023 年 10 月)
- 〈継続事項〉
- (1) JEITA 規格の制定・改定
 - ・ ET-7411 [極小表面実装部品のはんだ付け性試験方法 (平衡法)] の試験条件の見直し
 - ・ JEITA/ETR-7001 (表面実装用語) の改定
 - ・ ETR-7032 「電気・電子部品の使用温度に関する現状の温度規定及び課題に対するガイドライン」 続編検討
 - ・ ETR-7033 「電気・電子部品の温度測定方法に関するガイダンス」 続編検討
 - ・ ETR-7034 「基板放熱型部品を実装したプリント基板の熱設計ガイドライン」 続編検討
 - (2) JIS 草案作成委員会のフォロー
 - ・ JIS C 60068-2-21 (第 2-21 部: 試験一試験 U: 端子強度試験方法) 改正 (JEITA での審議終了) JSA での審議。 (2023 年度発行予定)
 - (3) 標準化 G, PG 設立・改廃
 - ・ なし
 - (4) IEC 国際規格案の作成・提案・検討・審議・投票, 国際間調整
 - ・ IEC 62878-2-603 : Guideline for stacked electronic module Evaluation method of intra module electrical connectivity
 - ・ IEC TR 62878-2-9 Guidelines - Concept of JISSO level in the electronic assembly technology industries
 - ・ IEC 60068-2-20 Environmental testing - Part 2-20: Tests - Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads (FDIS)
 - ・ IEC 60068-2-83 Test Tf: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method using solder past
 - ・ IEC TR 60068-3-12 Method to evaluate a possible lead-free solder reflow temperature profile
 - ・ IEC 60194-2 Ed. 2.0 : Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary -Part 2: Common usage in electronic technologies as well as printed board and electronic assembly technologies
 - ・ IEC 61189-5-301 Test methods for printed board assemblies - Soldering paste using fine solder particles
 - ・ IEC 61188-6-1 Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-1: Land pattern design - Generic requirements for land pattern on circuit boards
 - ・ IEC 61188-6-3 Land pattern design - Description of land pattern for through hole components
 - ・ IEC 63215-1 Evaluation Test Methods for die Attach Materials Applied to Power devices - Part 1: General Specification (CD)
 - ・ IEC 63215-2 ED.1 : Endurance test methods for die attach materials - Part 2: Temperature cycling test method for die attach materials applied to discrete type power electronic devices (FDIS)
 - ・ IEC 63215-3 ED.1: Endurance test methods for die attach materials - Part 3:

	<p>Power cycling test method and reliability performance index for die attach materials applied to discrete type power electronic devices (CD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IEC 63215-4 Ed.1: Endurance test methods for die attach materials - Part 4: Power cycling test method for die attach materials (near chip interconnection) applied to module type power electronic devices (CD) ・ IEC 63215-5 Ed.1: Endurance test methods for die attach materials -Part 5: Temperature cycling test methods and reliability performance index for die attach materials (system soldering interconnection) applied to module type power electronic devices (CDV) <p>(5) <u>規格化・標準化のための調査・研究・検証</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ET-7411「極小表面実装部品のはんだ付け性試験方法（平衡法）」試験条件の見直し ・ 新はんだ材料系ではんだ付け試験の調査及び検討 ・ 低温実装におけるウイスカ発生検証実験に関する実装技術標準化検討 <p>(5) <u>関連団体との連携（JEITA 内委員会, JWES など）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ IEC TC91 国内委員会への協力 ・ JEITA 標準化関連委員会との連携 受動部品標準化 WG, 接続部品標準化 WG, 機構部品標準化専門委員会, 半導体実装・製品技術専門委員会など ・ IEC SC47D 国内委員会との連携推進 <p>(6) <u>活動成果の広報・普及（報告会, 講演会, 出版, WEB 発信）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ JEITA ホームページで実装技術標準化専門委員会の紹介 <p>(7) <u>海外業界団体との合同会議</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ JIC (JISSO International Council) 主催 <p><事業計画テーマの推進方法> 専門委員会に標準化 G を組織して, 技術領域ごとにリソース集中と対応窓口を一元化する。さらに, 必要により, 各標準化 G 内又は専門委員会に個別テーマ毎に, PG (Project Group) を設置して進める。</p> <p><その他> <u>国家プロジェクトとの関連</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「AI エッジ用インテリジェントモジュールの三次元実装評価方法に関する国際標準化 (METI 委託, 取纏め: 福岡 IST)」の推進協力 ・ 「複合材料電子回路基板の放熱設計に関わる計測方法の国際標準化」の推進協力
--	---

事務局	(社) 電子情報技術産業協会 事業推進部 (担当: 横倉・布川・澤田)
-----	-------------------------------------